

公司代码：688019

公司简称：安集科技



安集微电子科技（上海）股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之二、风险因素。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以实施2020年度利润分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为53,108,380股，以此计算合计拟派发现金红利总额为15,932,514.00元（含税），占母公司当年实现可分配利润比例约11.01%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的10.35%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	安集科技	688019	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨逊	冯倩
办公地址	上海市浦东新区碧波路889号E座1-3楼	上海市浦东新区碧波路889号E座1-3楼
电话	021-20693201	021-20693201
电子信箱	IR@anjimicro.com	IR@anjimicro.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和光刻胶去除剂的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。

在化学机械抛光液板块，公司积极加强并全面开展全品类产品线的布局，旨在为客户提供完整的一站式解决方案。一方面，公司化学机械抛光液包括硅抛光液，浅槽隔离（STI）抛光液，介质层抛光液，钨抛光液，铜以及铜阻挡层抛光液，硅通孔（TSV）抛光液和基于氧化铈磨料的抛光液等系列产品。另一方面，抛光后清洗液是化学机械抛光工艺过程中使用的配套材料，包括铜制程抛光后清洗液，钨制程抛光后清洗液，铝制程抛光后清洗液以及抛光垫清洗液等系列产品。同时，公司还基于化学机械抛光液技术和产品平台，支持客户对于不同制程的需求，定制开发用于新技术新工艺的化学机械抛光液。公司产品已供应国内外多家逻辑芯片和存储芯片制造商，并成为国内主流的抛光液供应商。公司化学机械抛光液已成功用于 130-14nm 逻辑芯片工艺、存储芯片工艺和三维集成工艺，10-7nm 技术节点产品正在研发中。为了支持第三代半导体发展，公司已积极开展相应抛光液产品的技术开发与测试验证。

在光刻胶去除剂板块，公司专注致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案。根据光刻胶下游应用领域不同，公司光刻胶去除剂包括集成电路制造用、晶圆级封装用、LED/OLED 用等系列产品。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司制定了《采购管理程序》和采购管理内部控制流程，并制定了《采购流程》、《供应商管

理流程》、《供应灾难恢复程序》等标准作业程序。

（1）一般采购流程

以原、辅材料和包装材料为例，公司的一般采购主要流程如下：

①技术研发部提出材料开发需求，采购部负责开发供应商，并由供应商管理小组负责材料评估、供应商认证、审核、导入及批准为公司合格供应商，采购部负责建立并维护《合格供应商目录》。公司供应商管理小组由采购部、技术研发部、质量部、生产运营部等部门人员组成。

②需求部门提出采购申请，并按照公司审批政策得到合适的批准后提交采购部，采购部负责管理订单执行，质量部负责采购来料检验管理，仓库负责采购入库管理。

③采购部按照采购合同/订单，获取发票，并整理入库及验收等付款凭证提交财务部申请付款并得到审批。

④财务部按照采购合同/订单约定负责采购应付款管理。

（2）外协采购流程

报告期内，公司产品 LED/OLED 用光刻胶去除剂存在委托外协供应商生产的情形，即公司与外协供应商签订协议，外协供应商严格按照公司提供的工艺文件、技术标准来组织生产，进行质量管理控制。公司所有的产品配方、生产工艺、任何发明、设计、技术信息、技术、专有技术或者由公司依协议授权外协供应商使用的商标、商业秘密及其他知识产权属于公司单独所有。公司的外协采购主要流程如下：

①生产运营部根据月度销售预测生成外协采购申请单；

②采购部根据外协采购申请单下订单；

③外协供应商按订单要求安排生产；

④财务部每月末进行外协采购成本核算。

2、研发模式

公司始终围绕自身的核心技术，以自主研发、自主创新为主，形成了科研、生产、市场一体化的自主创新机制。同时，公司与高校、客户等外部单位建立了良好的合作关系，积极开展多层次、多方式的合作研发。公司的研发目标一方面系跟随行业界的技术发展路线图，研发适应产业需求的产品平台；另一方面系基于下游客户的需求，针对性研发满足客户需求的产品。由于从开始研发到实现规模化销售需要较长的时间，公司与技术领先的客户合作开发，有助于了解客户需求并为其开发创新性的解决方案。

公司制定了《研发管理制度》，并建立了研发管理内部控制流程，涵盖研发计划、研发立项、

研发过程跟进和费用核算管理、专利申请和取得等环节。公司产品研发及产业化的一般路径主要包括项目论证、研发 Alpha 送样、Beta 送样试生产、商业化（规模化生产）、持续改进等五个阶段。

3、生产模式

公司在产品设计及研发前期，即投入大量资源与下游客户进行技术、品质、性能交流。当产品通过客户评价和测试后，销售部会根据客户的产品订单及对于客户使用需求的预测制定滚动出货预测，生产运营部根据年度/月度生产计划、滚动出货预测和库存情况制订具体的生产计划、安排库存。具体而言，生产运营部每年组织各相关部门，根据排产计划编制年度生产计划及月度生产计划。生产运营部会定期进行集体评审，根据每月存货存量、滚动出货预测制定具体的生产计划，以确保生产计划满足销售合同以及生产产能的要求；生产运营部组织各相关部门、各产品线负责人召开生产调度会，对生产计划的执行情况进行评审，以确保充分沟通可能影响生产计划变更的各种因素，及时调整生产计划（如及时关闭停工订单），以确保计划调整的及时性及有效性。

公司已经掌握了化学机械抛光液和光刻胶去除剂生产中的核心技术，通过合理调配机器设备和生产资源组织生产。

4、销售模式

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，销售主要采用直接面对终端客户的直销模式。公司在开拓新客户或在原有客户推广新产品时，首先要根据客户的需求进行认证测试，包括产品性能、可靠性、稳定性等多方面测试，认证测试周期一般较长。公司在通过下游客户认证后，客户直接向公司下达采购订单，公司按要求直接向客户发货。同时，公司积极拓展全球市场，已在美国、新加坡等国家建立经销渠道。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

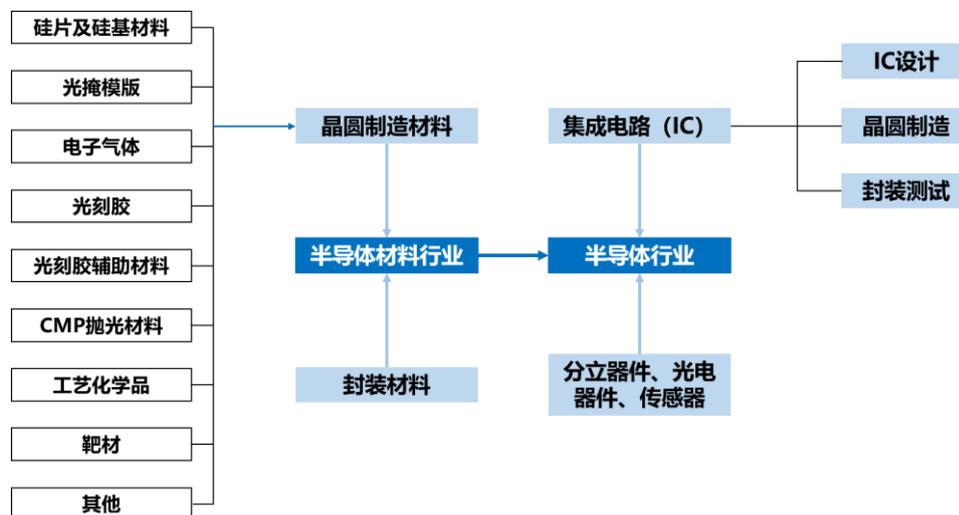
(1) 行业定位

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局《2017 年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985 电子专用材料制造”。按照行业界的一般分类标准，公司所处行业为半导体材料行业。

半导体材料属于半导体行业的细分行业领域。根据 WSTS 的统计，半导体主要包括集成电路（IC）、分立器件、光电器件和传感器四大类，这其中集成电路市场规模占比超过 80%。集成电路根据产品类别大致分为逻辑电路、存储器、模拟电路和微处理器四大类别。而按照生产制造的流

程，集成电路行业可以分为集成电路设计、晶圆制造和封装测试三大组成部分。按照行业界的一般标准，半导体材料通常指的是晶圆制造和封装测试过程中所需的材料。

半导体材料行业概况



资料来源：根据 SEMI 资料整理

(2) 行业发展阶段

集成电路产业按照摩尔定律持续发展，制程节点不断缩小。芯片的制程就是用来表征集成电路尺寸大小的一个参数，随着摩尔定律的发展，集成电路制程节点从 1971 年 10 微米一直发展到现在的 10 纳米、7 纳米、5 纳米。

逻辑芯片方面，各晶圆制造厂商的市场地位基本由其最先进制程节点所决定。从逻辑芯片制造最先进技术节点来看，目前台积电处于国际领先地位。中芯国际是国内领先的代工厂，目前 14nm 工艺制程芯片已经实现量产。

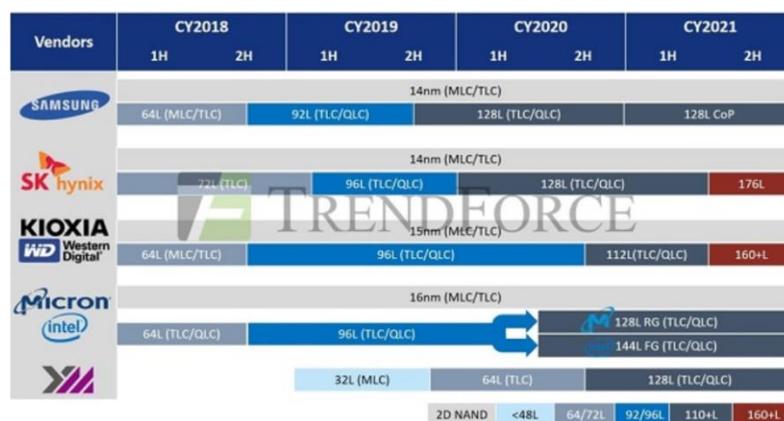
逻辑/晶圆代工厂商工艺演进图（量产）

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Intel	14nm+	10nm (limited) 14nm++		10nm	10nm+	10nm++	7nm EUV
Samsung	10nm		8nm	7nm EUV 6nm EUV	18nm FDSOI 5nm	4nm	3nm GAA
TSMC	10nm	7nm 12nm	7nm+ EUV	5nm	6nm	5nm+	4nm 3nm
GlobalFoundries			22nm FDSOI 12nm finFET		12nm FDSOI	22nm+ FDSOI 12nm+ finFET	
SMIC				14nm finFET	12nm finFET		8-10nm finFET
UMC		14nm finFET			22nm planar		

数据来源：IC Insights

存储芯片方面，以 NAND Flash 和 DRAM 为主，两者合计占到了存储芯片超过 95% 的份额。存储芯片是一个高度垄断的市场，三星、SK 海力士、美光，合计占据全球 DRAM 市场 95% 左右的份额，NAND Flash 经过几十年的发展，已经形成了由三星、铠侠、西部数据、美光、SK 海力士、英特尔六大原厂组成的稳定市场格局。存储芯片行业属于技术密集型产业，中国存储芯片行业起步较晚，与国外存储芯片制造商相比仍存在一定差距。中国本土长江存储、合肥长鑫和福建晋华三大存储芯片企业已逐步完善 NAND 和 DRAM 产业布局，缩小与国外存储芯片制造商的差距。以 3D NAND 存储器为例，长江存储（YMTC）2018 年发布突破性技术 Xtacking®，该技术将为 3D NAND 闪存带来前所未有的 I/O 高性能、更高的存储密度以及更短的产品上市周期。长江存储已成功将 Xtacking® 技术应用于其第二代 3D NAND 产品的开发，2020 年推出 128 层 3D NAND 闪存。

NAND Flash 大厂技术量产制程



数据来源：TrendForce

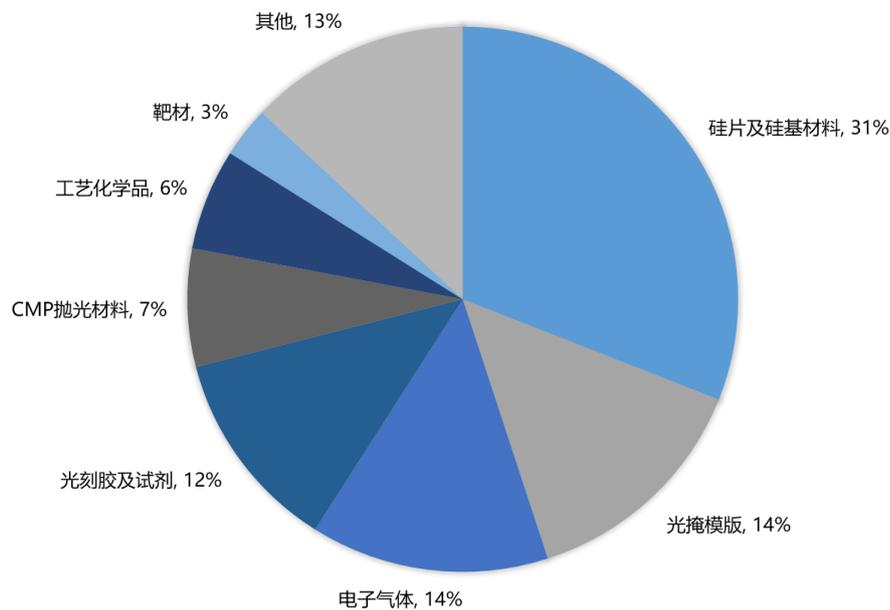
随着半导体技术不断演进，进入“超越摩尔”时代，半导体大厂的发展重点逐渐从过去着力于晶圆制造工艺技术节点的推进，转向系统级设计制造封装技术的创新，先进封装在整个半导体产业链中的重要性将越来越突出，更将成为后摩尔时代半导体技术的重要发展指标。先进封装主要是指倒装、晶圆级封装、2.5D 封装、3D 封装等封装技术。全球集成电路封装测试业由封装测试代工厂商（OSAT）和 IDM 封装测试两部分组成，各占约一半的市场份额。10 多年来，各种先进封装技术的快速发展，不仅满足了各种集成电路产品对封装技术的要求，而且在发展复杂的异构集成技术方面，越来越凸显出先进封装技术的优越性。根据 Yole，2017 年到 2023 年，全球先进封装市场规模以 7% 以上的复合增长率发展，到 2023 年规模将达到 390 亿美元。包括台积电、武汉新芯、联电和中芯国际在内的单纯代工厂正在涉足高端封装业务，为其客户提供一站式解决方案；像日月光、艾克尔、长电科技、硅品等封测厂商正以相当可观的投入力度开发先进的晶圆级和 3D IC 封装产能，以支持尺寸和密度方面的需求。在国内，长电科技、华天科技和通富微电均

在加大研发投入与产出，并在相关领域内取得突破。

根据 WSTS 的最新报告，2020 年全球半导体市场规模较 2019 年增长 6.8%，达到 4,400 亿美元，主要是由于集成电路和传感器市场规模增长；2021 年，全球半导体市场规模将增长 10.9%，达到 4,880 亿美元，集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等半导体产品类别均将有所增长。IC Insights 更是将 2021 年 IC 市场的增长率从 12%上调到了 19%。根据 SEMI 的最新报告，2020 年全球半导体材料市场实现 4.9%增长，达到 553 亿美元。其中，中国大陆市场规模超过韩国达到 97.6 亿美元，同比增长 12%，跃居全球第二。

根据 SEMI 的分类标准，半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料两大类，晶圆制造材料主要分为硅片及硅基材料、光掩模版、电子气体、光刻胶及试剂、CMP 抛光材料、工艺化学品、靶材和其他。根据 SEMI 的最新报告，2020 年，晶圆制造材料市场规模为 349 亿美元，较 2019 年增长 6.5%，约占半导体材料整体规模的 63%，其中光刻胶及试剂、工艺化学品和 CMP 抛光材料增长最为强劲。根据 SEMI 的资料整理，晶圆制造材料中 CMP 抛光材料约占 7%，CMP 抛光材料可以细分为抛光液、抛光垫等，其中抛光液占到整个 CMP 抛光材料的一半份额。

晶圆制造材料细分品类及占比



数据来源：根据 SEMI 数据整理

(3) 行业技术门槛

尽管摩尔定律在不断被挑战，集成电路制造技术仍然在世界范围内不断被更新并向更先进的技术推进，化学机械抛光技术也不例外，这就对 CMP 工艺使用的关键材料（即化学机械抛光材料，主要包括化学机械抛光液和抛光垫）尤其是抛光液提出了更高要求，主要体现在“难”、“专”、“多”

三个方面：

(a) “难”。集成电路产业能够延续摩尔定律不断发展，离不开半导体材料性能的改善和新材料的应用。为了提高集成电路的性能，集成电路制造商逐步增加每块集成电路上电子元器件与布线层的数量和密度并不断引进新的介质和导电材料，这增加了集成电路的复杂性和对 CMP 抛光材料尤其是起着最关键作用的抛光液的相关需求。在“难”方面，在从微米到纳米级别的器件线路上，对不同材料的去除速率、选择比及表面粗糙度和缺陷都要求精准至纳米乃至埃（分子级）。如此精准的控制需要通过精制、定制抛光液在宏观的抛光机台和抛光垫的作用下完成，这些高难工艺对抛光液的性能提出了极大的挑战。随着技术节点的推进，在 14 纳米、10 纳米、7 纳米、5 纳米等更先进的制程节点，CMP 工艺将面临各种高难度的挑战，对抛光材料尤其是抛光液将提出前所未有的高难度技术要求。

(b) “专”。在逻辑芯片、存储芯片等集成电路技术不断推进过程中，对抛光材料，尤其是抛光液的需求出现了“专”的趋势和特征，客户和供应商联合开发成为成功的先决条件。即使是同一技术节点，不同客户的集成技术不同，对抛光液的需求也不同。

(c) “多”。在集成电路技术不断推进过程中，必然出现多种新技术和新材料，这些新技术和新材料对抛光工艺材料提出了许多新的要求。随着集成电路技术的进步和对集成电路性能要求的增加，下游客户在制造过程中使用 CMP 工艺的集成电路比例在不断增加对以 CMP 抛光液为主的材料种类和用量的需求也在增加。更先进的逻辑芯片工艺可能会出现新的器件材料需要抛光工艺，为 CMP 抛光液带来了更多的增长机会，比如 14 纳米以下逻辑芯片工艺要求的关键 CMP 工艺将达到 20 步以上，使用的抛光液将从 90 纳米的五六种抛光液增加到二十种以上，种类和用量迅速增长；7 纳米及以下逻辑芯片工艺中 CMP 抛光步骤甚至可能达到 30 步，使用的抛光液种类接近三十种。同样地，存储芯片由 2D NAND 向 3D NAND 技术变革，也会使 CMP 抛光步骤数近乎翻倍。

清洗液涉及表面科学、流体力学、电化学、材料化学、纳米科学等交叉学科。在产品配方方面，公司研发人员基于对光刻胶残留物成分、基材特性、颗粒控制等方面的理解，通过反复、大量的实验、测试、检验分析等流程确定产品配方，并通过申请专利等方式加以保护。在生产工艺流程方面，通过各种工艺参数的设计、研究和实验等方法来确定生产工艺路线，形成公司技术秘密予以保护。特别是集成电路领域高端光刻胶去除剂，鉴于其图形尺寸只有纳米级，对产品配方及生产流程控制要求更高，目前国内仅有极少数供应商具有供应能力。

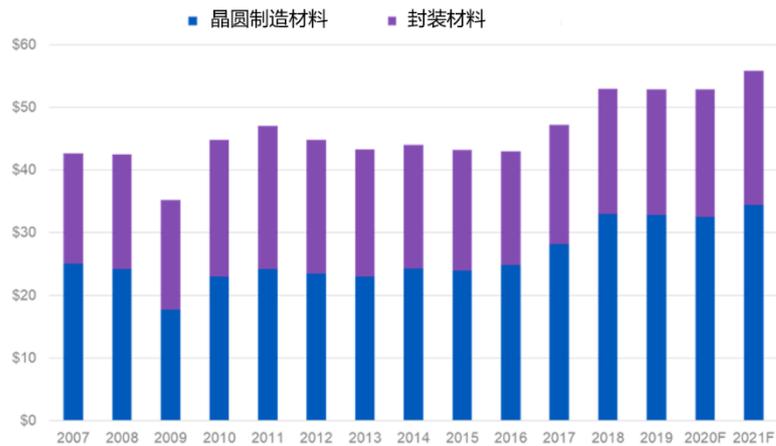
(4) 行业基本特点

半导体材料行业不仅技术门槛高，也是一个产业规模大、细分行业多，同时投入大、见效慢、

周期长，但稳定性高的行业。

第一，产业规模大。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料。根据 SEMI 的最新报告，2020 年全球半导体材料销售额为 553 亿美元，相较于 2019 年增长 4.9%。其中，中国台湾市场规模达到 123.8 亿美元，同比增长 8.2%，继续位居全球第一。中国大陆市场规模超过韩国达到 97.6 亿美元，同比增长 12%，跃居全球第二。2020 年，全球晶圆制造材料市场规模约为 349 亿美元，较 2019 年增长约 6.5%，约占半导体材料整体规模的 63%。

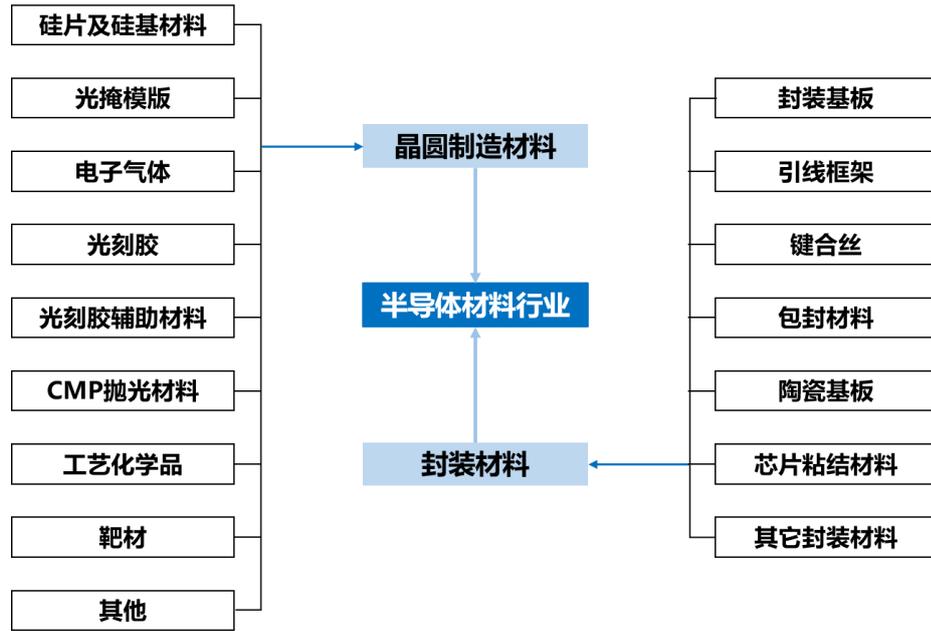
全球半导体材料市场规模（单位：十亿美元）



数据来源：根据 SEMI 数据整理

第二，细分行业多。半导体材料行业是半导体产业链中细分领域最多的产业链环节，其中晶圆制造材料包括硅片及硅基材料、光掩模版、电子气体、光刻胶及试剂、CMP 抛光材料、工艺化学品、靶材及其他材料；封装材料包括封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘结材料及其他封装材料。每一种大类材料又包括几十种甚至上百种具体产品，细分子行业多达上百个。

半导体材料分类

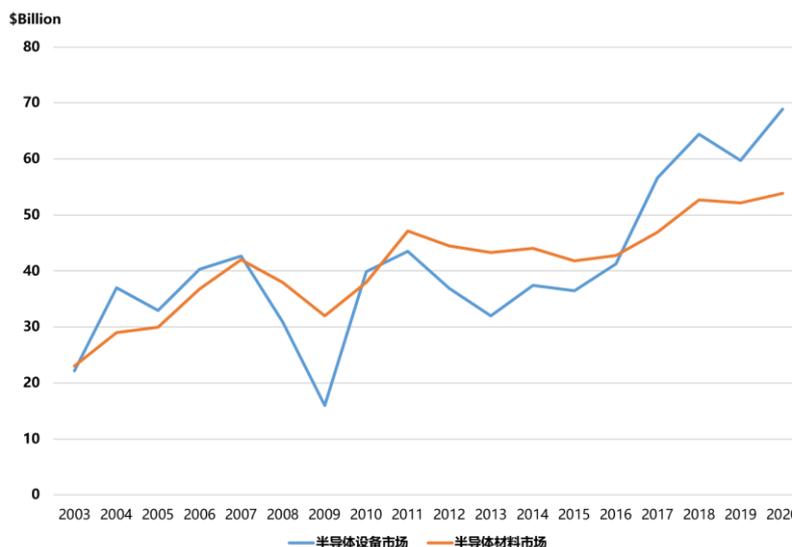


资料来源：根据 SEMI 资料整理

第三，投入大、见效慢、周期长。尽管半导体材料产成品是属于材料，但由于其在集成电路芯片制造中扮演着重要的角色，甚至部分关键材料直接决定了芯片性能和工艺发展方向，因此下游客户对于产品的要求极为苛刻，在上线使用前需要长周期的测试论证工作，并且上线使用后也会通过较长周期逐步上量。加之产品在能够进入测试论证阶段之前需要经历长时间、高难度的研发阶段，研发过程中需要大量的研发投入。

第四，稳定性高。正是因为前期需要漫长的过程才能够真正实现销售，并且这个过程中客户的成本同样很高，使得客户更换产品的成本较高，加上材料本身易耗的特点，致使行业稳定性较高。

全球半导体设备市场及半导体材料市场规模变化趋势



数据来源：根据 SEMI、WSTS 数据整理

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和光刻胶去除剂的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。公司经过多年以来的技术和经验积累、品牌建设，凭借扎实的研发实力及成本、管理和服务等方面的优势，在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌知名度。目前在国内，公司已成为化学机械抛光液领域主流的供应商，并与领先用户紧密合作共同开发行业技术领先制程专用产品，根据 SEMI 最新的报告整理，公司 CMP 抛光液在全球市场的份额由 2019 年的 3%左右成长到 2020 年的 4.5%左右。在光刻胶去除剂板块，公司致力于先进制程用技术及产品开发，已成为技术领先的本土供应商，产品广泛用于逻辑、存储、晶圆级封装及 LED/OLED 等芯片制造工艺。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期及过去的几年内，手机和个人电脑仍是芯片业的最大市场。而其他新兴应用领域，比如汽车电子、物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等也有了积极的发展。在未来的几年，预计 5G 通信、人工智能、宽禁带半导体等应用领域会有积极的增长。尤其是 5G 通信市场，预计在未来的几年会因为终端和基站的高速增长，形成较大的市场规模。由于这类芯片对性能和尺寸的高要求，对材料和设备产业的产品和市场都产生积极的促进作用。同时，小芯片组（chiplet）技术也是未来发展的热点，这一新兴高端集成封装技术将对芯片产业产生重大的影响，而这一技术的实施也将使化学机械抛光成为高端封装的重要工艺之一。而宽禁带半导体也在电动汽车、射频和电力电子方面有很好的发展预期，这些发展将带来抛光液和清洗

液的发展。安集一方面在不断扩大市场占有率，另外也抓住整个市场的增量带来的商机。

IC Insights 预计全球 IC 市场销售额将在 2021 年平均增长 19%，并在最新的 2021 年版《麦克林报告 (The McClean Report)》中分析和预测排名前十的 IC 产品类别预计销售额增幅都将超过两位数，前五类 IC 产品增长速度更是将超过 12% 的平均增速，分别是 DRAM、NAND 闪存、汽车专用模拟、汽车专用逻辑、嵌入式 MPU。其中，DRAM 和 NAND 闪存被认为会是 2021 年增长最快的两个产品领域，预计销售额分别增长 18% 和 17%。DRAM 销售额增速如此之高一定程度上是受其明显的周期性影响；而新冠肺炎疫情迫使许多消费者、学校、企业和政府之间的沟通和开展业务方式发生了转变，笔记本、平板电脑和服务器销量增长迅速，这也使得 NAND 闪存市场增长迅速。5G 技术向智能手机和计算应用的普及，预计将继续带来 NAND 闪存市场的繁荣，进而支撑其在 2021 年的增长。

2020 年受疫情冲击，对汽车 IC 销量产生不利影响。但是汽车需求在 2020 年下半年迅速回升，导致许多汽车 IC 产品短缺，芯片价格一路走高。随着 2021 年汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长，预计将使每辆汽车的平均半导体器件价格提高到 550 美元以上，这也将极大地提升车载 IC 市场收入。

在目前的 AI 领域，边缘学习将逐渐成为新的趋势，而 GPU、DSP 和 VPU 这样的高性能计算平台带来的高能耗很难在本地进行，对已有的微处理器和微控制器的构架进行升级就成为了一个可行的方式。未来，嵌入式 MPU 和 MCU 市场或会因为 AI 技术的成熟而变得更加重要，为 IC 产品的增长提供了保障。

目前 IC Insights 预测将在 2021 年增长最快的 IC 产品如 DRAM、NAND、汽车芯片和嵌入式系统，都是智能汽车、5G 技术、云计算、物联网和 AI 领域等新兴领域最核心的技术产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减 (%)	2018年
总资产	1,287,346,347.95	991,198,926.40	29.88	433,314,552.28
营业收入	422,379,914.28	285,410,172.10	47.99	247,848,714.83
归属于上市公司股东的净利润	153,989,118.92	65,846,041.18	133.86	44,962,447.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,850,726.56	43,031,261.59	36.76	43,129,761.73
归属于上市公司股	1,048,104,787.37	887,569,640.68	18.09	346,757,773.40

东的净资产				
经营活动产生的现金流量净额	113,173,725.28	84,682,099.91	33.65	59,763,009.36
基本每股收益(元/股)	2.90	1.45	100.00	1.13
稀释每股收益(元/股)	2.90	1.45	100.00	1.13
加权平均净资产收益率(%)	15.94	11.40	增加4.54个百分点	13.87
研发投入占营业收入的比例(%)	21.05	20.16	增加0.89个百分点	21.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	96,338,088.07	95,403,921.05	116,963,508.03	113,674,397.13
归属于上市公司股东的净利润	23,556,378.57	26,246,085.83	63,801,805.25	40,384,849.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,734,941.39	26,262,992.8	15,999,301.1	-6,146,508.73
经营活动产生的现金流量净额	-3,233,327.18	26,520,366.82	8,230,144.66	81,656,540.98

注：根据 2021 年 2 月 6 日财会〔2021〕2 号通知，公司报告期内购买的结构性存款产生的利息应计入投资收益或公允价值变动损益，公司于第四季度将全年的利息收入从财务费用调整至投资收益和公允价值变动损益。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,004
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,654
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
前十名股东持股情况	

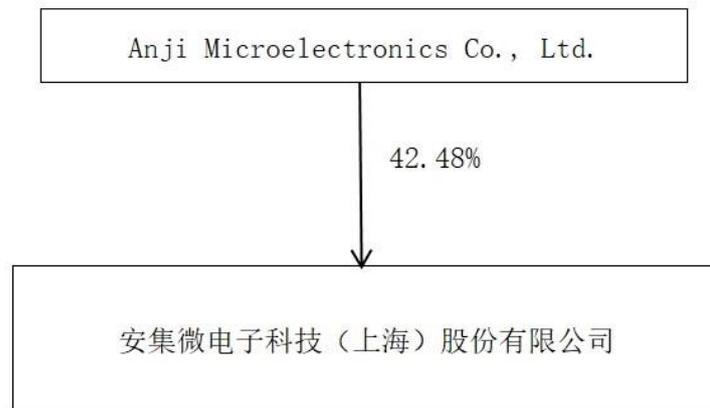
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
AnjiMicroelectronics Co., Ltd.	0	22,560,328	42.48	22,560,328	0	无	0	其他
国家集成电路产业投 资基金股份有限公司	0	6,144,572	11.57	0	0	无	0	国有 法人
招商银行股份有限公 司—银河创新成长混 合型证券投资基金	2,445,849	2,500,227	4.71	0	0	无	0	其他
上海张江科技创业投 资有限公司	-1,378,464	2,170,271	4.09	0	0	无	0	国有 法人
上海大辰科技投资有 限公司	-500,000	1,900,028	3.58	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
中国银行股份有限公司—国泰CES半导 体芯片行业交易型开 放式指数证券投资基金	1,037,506	1,037,506	1.95	0	0	无	0	其他
苏州中和春生三号投 资中心(有限合伙)	-1,420,973	893,536	1.68	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公 司—华夏上证科创板 50成份交易型开 放式指数证券投资基金	547,175	547,175	1.03	0	0	无	0	其他
申银万国创新证券投 资有限公司(注)	461,700	483,755	0.91			无	0	其他
中国建设银行股份有 限公司—南方信息创 新混合型证券投资基 金	474,376	474,376	0.89	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知前十名无限售条件股东和前十名 股东之间存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				无				

存托凭证持有人情况

适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 42,237.99 万元，比去年同期增长 47.99%；归属于上市公司股东的净利润为 15,398.91 万元，较去年同期增长 133.86%。

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详情请见本年报第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估算 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计 3 家，本期合并范围未发生变化，具体参见 2020 年年度报告的“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

安集微电子科技（上海）股份有限公司

法定代表人：Shumin Wang

2021 年 3 月 30 日